



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2017-0038544
(43) 공개일자 2017년04월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 51/52 (2006.01) H01L 27/32 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H01L 51/5246 (2013.01)
H01L 27/3225 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2015-0138055
(22) 출원일자 2015년09월30일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
엘지디스플레이 주식회사
서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)
(72) 발명자
이신우
서울특별시 구로구 신도림로 16 e편한세상대림2차
아파트 203동 602호
(74) 대리인
특허법인인벤투스

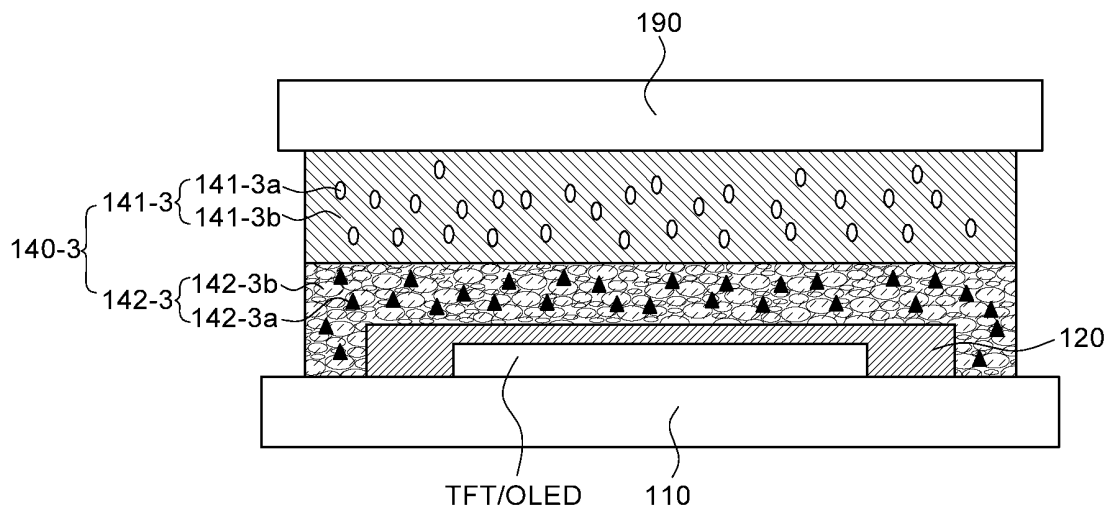
전체 청구항 수 : 총 16 항

(54) 발명의 명칭 유기발광 표시장치

(57) 요약

본 명세서는 유기발광 표시장치를 개시한다. 상기 유기발광 표시장치는, TFT(Thin Film Transistor) 어레이 기판 위에 있는 유기발광 소자; 상기 유기발광 소자를 덮어 수분 또는 산소의 침투를 막는 면 봉지재(face seal encapsulation)를 포함하며, 상기 면 봉지재는, 수분 흡착제를 함유한 제1 봉지층 및 미세 구조체를 함유한 제2 봉지층을 구비하고, 상기 미세 구조체는, 상기 면 봉지재와 상기 유기발광 소자의 합착 시에 상기 제2 봉지층의 점성(viscosity)을 증가시킨다.

대표도 - 도7



(52) CPC특허분류

H01L 27/3262 (2013.01)

H01L 51/5253 (2013.01)

H01L 2227/32 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

TFT(Thin Film Transistor) 어레이 기관 위에 있는 유기발광 소자; 및
상기 유기발광 소자를 덮어 수분 또는 산소의 침투를 막는 면 봉지재(face seal encapsulation)를 포함하며,
상기 면 봉지재는, 수분 흡착제를 함유한 제1 봉지층 및 미세 구조체를 함유한 제2 봉지층을 구비하고,
상기 미세 구조체는, 상기 면 봉지재와 상기 유기발광 소자의 합착 시에 상기 제2 봉지층의 점성(viscosity)을 증가시키는 유기발광 표시장치.

청구항 2

제1 항에 있어서,
상기 제2 봉지층은, 외부로부터 압력을 받으면 상기 미세 구조체로 인하여 딜레이턴트(dilatant) 성질을 갖는 유기발광 표시장치.

청구항 3

제2 항에 있어서,
상기 제2 봉지층은, 상기 유기발광 소자와의 접착 공정에서 상기 면 봉지재에 전단력(shearing force)이 가해지는 경우에, 상기 미세 구조체로 인하여 점성이 증가하여 상기 TFT 어레이 기관의 외부로 흘러 넘치지 않는 유기발광 표시장치.

청구항 4

제1 항에 있어서,
상기 미세 구조체의 크기는 100 나노미터(nm) 이하인 유기발광 표시장치.

청구항 5

제4 항에 있어서,
상기 미세 구조체는 몬모릴로나이트 점토(montmorillonite clay)인 유기발광 표시장치.

청구항 6

제1 항에 있어서,
상기 제2 봉지층은, 상기 유기발광 소자와의 접착 시에 갇힌 기포가 빠져나가도록 구비된 공극(pore)을 더 포함하는 유기발광 표시장치.

청구항 7

제6 항에 있어서,
상기 제2 봉지층의 두께는, 상기 공극이 차지하는 부피 및 상기 공극을 통한 외기의 유입을 고려하여 결정된 유기발광 표시장치.

청구항 8

제7 항에 있어서,
상기 제1 봉지층은, 상기 제2 봉지층의 두께에 기반하여 결정된 양의 수분 흡착제를 함유하는 유기발광 표시장치.

청구항 9

제1 항에 있어서,

상기 제2 봉지층은, 상기 유기발광 소자 상의 보호막 및 상기 유기발광 소자 주위의 TFT 어레이 기판과 접촉되고,

상기 제1 봉지층은, 상기 TFT 어레이 기판과 대향하는 봉지(encapsulation) 기판과 접촉된 유기발광 표시장치.

청구항 10

제9 항에 있어서,

상기 봉지 기판은 금속 또는 유리로 이루어진 유기발광 표시장치.

청구항 11

유기발광 소자로의 투습을 막는 다층 구조의 면 접착(face seal adhesive) 필름으로서,

경화성 수지와 수분 흡착제를 포함하는 제1 봉지층; 및

투명한 경화성 수지와 미세 구조체를 포함하며, 상기 제1 봉지층과 접촉된 제1 면 및 상기 제1 면의 반대 편에서 유기발광 소자의 상부를 덮는 제2 면을 갖는 제2 봉지층을 포함하고,

상기 제2 봉지층은, 상기 미세 구조체로 인하여 상기 유기발광 소자의 상부에 부착될 때 발생하는 팽창이 억제되는 면 접착 필름.

청구항 12

제11 항에 있어서,

상기 미세 구조체는, 100 나노미터(nm) 이하의 크기를 갖는 몬모릴로나이트 점토(montmorillonite clay)인 면 접착 필름.

청구항 13

제11 항에 있어서,

상기 제2 봉지층은, 외부로부터 압력을 받으면 상기 미세 구조체로 인하여 딜레이턴트(dilatant) 성질을 갖게 되어 점성(viscosity)이 증가하는 면 접착 필름.

청구항 14

제11 항에 있어서,

상기 제2 봉지층은, 상기 유기발광 소자 상부에 접촉되는 과정에서 상기 제2 면 및 제2 면과 합착되는 면 사이에 갇힌, 공기를 통과시키는 공극(pore)이 구비된 면 접착 필름.

청구항 15

유기발광 소자로의 투습을 막는 다층 구조의 면 접착(face seal adhesive) 필름으로서,

수분 흡착제를 포함하는 제1 봉지층; 및

상기 제1 봉지층과 상기 유기발광 소자의 사이에 위치하고, 상기 면 접착 필름과 상기 유기발광 소자의 상면 사이에 갇힌 공기를 통과시키도록 구비된 공극(pore)을 갖는 제2 봉지층;을 포함하는 면 접착 필름.

청구항 16

제15 항에 있어서,

상기 제1 봉지층은, 상기 제2 봉지층에서 상기 공극이 차지하는 부피 및 상기 공극을 통한 외기의 유입을 고려하여 결정된 양의 수분 흡착제를 포함하는 면 접착 필름.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 유기발광 표시장치 및 봉지 구조에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 다양한 정보를 화면으로 구현해 주는 영상표시장치는 정보 통신 시대의 핵심 기술로, 더 얇고 더 가볍고 휴대가 가능하면서도 고성능의 방향으로 발전하고 있다. 이에 유기 발광층의 발광량을 제어하여 영상을 표시하는 유기 발광 표시장치(OLED) 등이 각광받고 있다.

[0003] 유기발광 표시장치는 전극 사이의 얇은 발광층을 이용한 자발광 소자로 박막화가 가능하다는 장점이 있다. 또한, 유기발광 표시장치는 저전압 구동에 의해 소비 전력 측면에서 유리할 뿐만 아니라, 색상 구현, 응답 속도, 시야각, 명암 대비비(contrast ratio; CR)도 우수하다.

[0004] 일반적인 유기 발광 표시장치는 기판에 화소 구동 회로와 유기발광 소자가 형성된 구조를 갖고, 유기발광 소자에서 방출된 빛이 기판 또는 배리어층을 통과하면서 화상을 표시하게 된다. 유기발광 소자는 산소에 의한 전극 및 발광층의 열화, 발광층-계면간의 반응에 의한 열화 등 내적 요인에 의한 열화가 있는 동시에 외부의 수분, 산소, 자외선 및 소자의 제작 조건 등 외적 요인에 의해 쉽게 열화가 일어난다. 특히 외부의 산소와 수분은 소자의 수명에 치명적인 영향을 주므로 유기발광 표시장치의 봉지(encapsulation)가 매우 중요하다.

[0005] 봉지 방법 중 하나로 유기발광 소자의 상부를 보호용 필름으로 밀봉하는 방법이 있다. 상기 보호용 필름은 흡습제를 포함하여, 침투하는 수분을 흡수한다.

[0006] 보호용 필름을 유기발광 소자 위에 부착하는 공정에서 여러 가지 형태의 불량률이 발생한다. 이에 따라 열화 방지 성능이 약화되기 때문에 이에 대한 보완책이 필요하다. 더 나아가, 근원적으로 제조 공정에서의 작업 불량률이 발생될 확률이 적은 보호용 필름이 요구되고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 명세서의 목적은, 유기발광 표시장치 및 그에 사용되는 봉지(encapsulation) 구조를 제공하는 데 있다. 보다 구체적으로 본 명세서는 유기발광 소자로의 투습을 방지하기 위해 다층(multi-layer)으로 구성된 면 봉지 구조물을 제공하는 데 그 목적이 있다. 또한, 본 명세서의 또 다른 목적은, 제조불량이 저감되는 페이스 씸 접착 필름을 제공하는 데 있다.

과제의 해결 수단

[0008] 본 명세서의 일 실시예에 따라 유기발광 표시장치가 제공된다. 상기 유기발광 표시장치는, TFT(Thin Film Transistor) 어레이 기판 위에 있는 유기발광 소자; 상기 유기발광 소자를 덮어 수분 또는 산소의 침투를 막는 면 봉지재(face seal encapsulation)를 포함하며, 상기 면 봉지재는, 수분 흡착제를 함유한 제1 봉지층 및 미세 구조체를 함유한 제2 봉지층을 구비하고, 상기 미세 구조체는, 상기 면 봉지재와 상기 유기발광 소자의 합착 시에 상기 제2 봉지층의 점성(viscosity)을 증가시킨다.

[0009] 본 명세서의 다른 실시예에 따라 유기발광 소자로의 투습을 막는 다층 구조의 면 접착(face seal adhesive) 필름이 제공된다. 상기 면 접착 필름은, 경화성 수지와 수분 흡착제를 포함하는 제1 봉지층; 투명한 경화성 수지와 미세 구조체를 포함하며, 상기 제1 봉지층과 접착된 제1 면 및 상기 제1 면의 반대 편에서 유기발광 소자의 상부를 덮는 제2 면을 갖는 제2 봉지층을 포함하고, 상기 제2 봉지층은, 상기 미세 구조체로 인하여 상기 유기발광 소자의 상부에 부착될 때 발생하는 팽창이 억제된다.

[0010] 본 명세서의 또 다른 실시예에 따라 유기발광 소자로의 투습을 막는 다층 구조의 면 접착(face seal adhesive) 필름이 제공된다. 상기 면 접착 필름은, 수분 흡착제를 포함하는 제1 봉지층; 상기 제1 봉지층과 상기 유기발광 소자의 사이에 위치하고, 상기 면 접착 필름과 상기 유기발광 소자의 상면 사이에 갇힌 공기를 통과시키도록 구비된 공극(pore)을 갖는 제2 봉지층을 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [0011] 본 명세서의 실시예에 의하면 접착성과 팽창성이 모두 우수한 다층 구조의 면 봉지재를 통해 표시장치의 성능이 향상될 수 있다. 또한 본 명세서의 실시예에 따르면, 다층 구조의 면 봉지재를 사용하는 공정에서 나타나는 불량률을 줄일 수 있다. 즉, 본 명세서의 실시예에 따른 면 봉지재는 팽창성 불량과 합착 기포에 의한 불량률을 모두 감소시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0012] 도 1은 본 명세서의 실시예에 따른 유기발광 표시장치를 나타낸 평면도이다.
 도 2는 본 명세서의 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 표시 영역 중 일부를 나타낸 단면도이다.
 도 3은 유기발광 표시장치의 면 봉지재를 나타낸 도면이다.
 도 4a 및 4b는 면 접착 필름에서 나타날 수 있는 문제를 나타낸 도면이다.
 도 5는 본 명세서의 일 실시예에 따른 면 봉지재를 나타낸 단면도이다.
 도 6은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 면 봉지재를 나타낸 도면이다.
 도 7은 본 명세서의 일 실시예에 따른 유기발광 표시장치를 나타낸 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0013] 본 발명의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질, 차례, 순서 또는 개수 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 또는 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 다른 구성 요소가 "개재"되거나, 각 구성 요소가 다른 구성 요소를 통해 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 소자 또는 층이 다른 소자 또는 층 "위(on)"로 지칭되는 것은 다른 소자 바로 위에 또는 중간에 다른 층 또는 다른 소자를 개재한 경우를 모두 포함한다. 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 도시된 것이며, 본 발명이 도시된 구성의 크기 및 두께에 한정되는 것은 아니다.
- [0014] 본 명세서에서 “표시장치”로 지칭될 수도 있는 “유기발광 표시장치”는 유기 발광 다이오드 패널 및 그러한 유기 발광 다이오드 패널을 채용한 표시 장치에 대한 일반 용어로서 사용된다. 일반적으로, 유기발광 표시장치는 백색 유기 발광 타입 및 RGB 유기 발광 타입이 있다. 백색 유기 발광 타입에서, 화소의 각각의 서브 픽셀들은 백색 광을 발광하도록 구성되고, 컬러 필터들의 세트가 대응하는 서브 픽셀에서 적색 광, 녹색 광 및 청색 광을 생성하도록 백색 광을 필터링하는데 사용된다. 또한, 백색 유기 발광 타입은 백색 광을 생성하기 위한 서브 픽셀을 형성하기 위해 컬러 필터 없이 구성된 서브 픽셀을 포함할 수도 있다. RGB 유기 발광 타입에서, 각각의 서브 픽셀에서의 유기 발광층은 지정된 색의 광을 발광하도록 구성된다. 예를 들어, 하나의 픽셀은 적색 광을 발광하는 유기 발광층을 갖는 적색 서브 픽셀, 녹색 광을 발광하는 유기 발광층을 갖는 녹색 서브 픽셀, 및 청색 광을 발광하는 유기 발광층을 갖는 청색 서브 픽셀을 포함한다.
- [0015] 본 발명의 여러 실시예들의 각각 특징들이 부분적으로 또는 전체적으로 서로 결합 또는 조합 가능하고, 당업자에 의해 기술적으로 다양한 연동 및 구동될 수 있으며, 각 실시예들이 서로에 대하여 독립적으로 실시되거나 또는 연관 관계로 함께 실시될 수도 있다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 다양한 실시예들을 상세히 설명한다.
- [0016] 도 1은 본 명세서의 실시예에 따른 유기발광 표시장치를 나타낸 평면도이다.
- [0017] 도 1을 참조하면, 상기 유기발광 표시장치(100)는 적어도 하나의 표시 영역(active area, A/A)을 포함하고, 상기 표시 영역에는 픽셀(pixel)들의 어레이(array)가 배치된다. 하나 이상의 비표시 영역(inactive area, I/A)이 상기 표시 영역의 주위에 배치될 수 있다. 즉, 상기 비표시 영역은, 표시 영역의 하나 이상의 측면에 인접할 수 있다. 도 1에서, 상기 비표시 영역은 사각형 형태의 표시 영역을 둘러싸고 있다. 그러나, 표시 영역의 형태 및 표시 영역에 인접한 비표시 영역의 형태/배치는 도 1에 도시된 예에 한정되지 않는다. 상기 표시 영역 및 상기 비표시 영역은, 상기 표시장치(100)를 탑재한 전자장치의 디자인에 적합한 형태일 수 있다. 상기 표시 영역의

예시적 형태는 오각형, 육각형, 원형, 타원형 등이다.

- [0018] 상기 표시 영역 내의 각 픽셀은 픽셀구동회로와 연관될 수 있다. 상기 픽셀구동회로는, 하나 이상의 스위칭 트랜지스터 및 하나 이상의 구동 트랜지스터를 포함할 수 있다. 각 픽셀구동회로는, 상기 비표시 영역에 위치한 게이트 드라이버, 데이터 드라이버 등과 통신하기 위해, 게이트 라인 및 데이터 라인과 전기적으로 연결될 수 있다.
- [0019] 상기 게이트 드라이버, 데이터 드라이버는 상기 비표시 영역에 TFT(thin film transistor)로 구현될 수 있다. 이러한 드라이버는 GIP(gate-in-panel)로 지칭될 수 있다. 또한, 데이터 드라이버 IC와 같은 몇몇 부품들은, 분리된 인쇄 회로 기판에 탑재되고, FPCB (flexible printed circuit board), COF (chip-on-film), TCP (tape-carrier-package) 등과 같은 회로 필름을 이용하여 상기 비표시 영역에 배치된 연결 인터페이스(패드, 뱀프, 핀 등)와 결합될 수 있다. 상기 인쇄 회로(COF, PCB 등)는 상기 표시장치(100)의 뒤편에 위치될 수 있다.
- [0020] 상기 유기발광 표시장치(100)는, 다양한 신호를 생성하거나 표시 영역내의 픽셀을 구동하기 위한, 다양한 부가 요소들 포함할 수 있다. 상기 픽셀을 구동하기 위한 부가 요소는 인버터 회로, 멀티플렉서, 정전기 방전 회로(electro static discharge) 등을 포함할 수 있다. 상기 유기발광 표시장치(100)는 픽셀 구동 이외의 기능과 연관된 부가 요소도 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 유기발광 표시장치(100)는 터치 감지 기능, 사용자 인증 기능(예: 지문 인식), 멀티 레벨 압력 감지 기능, 촉각 피드백(tactile feedback) 기능 등을 제공하는 부가 요소들을 포함할 수 있다. 상기 언급된 부가 요소들은 상기 비표시 영역 및/또는 상기 연결 인터페이스와 연결된 외부 회로에 위치할 수 있다.
- [0021] 본 명세서에 따른 유기발광 표시장치는, 하부 기판(110) 상의 박막 트랜지스터 및 유기발광 소자, 유기발광 소자 위의 먼 봉지재(face seal), 기판과 먼 봉지재 사이에 함착된 배리어 필름(barrier film) 등을 포함할 수 있다. 하부 기판(110)은, 그 위에 형성된 소자 및 기능 층, 예를 들어 스위칭 TFT, 스위칭 TFT와 연결된 구동 TFT, 구동 TFT와 연결된 유기발광 소자, 보호막 등을 포함하는 개념으로 지칭되기도 한다.
- [0022] 하부 기판(110)은 유기발광 표시장치(100)의 다양한 구성요소들을 지지하고, 절연 물질로 형성된다. 하부 기판(110)은 투명한 절연 물질, 예를 들어 유리, 플라스틱 등과 같은 절연 물질로 형성될 수 있다.
- [0023] 하부 기판(110) 상에 유기발광 소자가 배치된다. 유기발광 소자는 애노드, 애노드 상에 형성된 유기 발광층 및 유기 발광층 상에 형성된 캐소드로 구성된다. 유기 발광층은 하나의 빛을 빛을 발광하는 단일 발광층 구조로 구성될 수도 있고, 복수 개의 발광층으로 구성되어 백색 광을 발광하는 구조로 구성될 수도 있다. 유기발광 소자는 표시 영역에 대응하도록 하부 기판(110)의 중앙 부분에 형성될 수 있다. 유기발광 소자의 유기 발광층이 백색 광을 발광하는 경우, 컬러 필터가 하부 기판(110)에 형성될 수도 있다.
- [0024] 보호막(passivation)이 유기발광 소자를 덮을 수 있다. 보호막은 유기발광 소자를 외부의 수분 또는 산소로부터 보호하기 위해 형성된다.
- [0025] 표시 영역(A/A)에 형성된 소자들 위에는 수분 및/또는 산소와 같은 기체의 침투를 방지하기 위한 봉지 층(encapsulation layer)이 구비될 수 있다. 상기 봉지 층으로 먼 봉지재(face seal)가 사용될 수 있다. 먼 봉지재의 일 예로 먼 접착 필름(face seal adhesive film)가 사용되기도 한다. 먼 접착 필름은 하부 기판(110)에 배치된 유기발광 소자를 밀봉하고, 하부 기판(110)과 상부 기판(봉지 기판)을 접착시킨다.
- [0026] 도 2는 본 명세서의 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 표시 영역 중 일부를 나타낸 단면도이다.
- [0027] 도 2를 참조하면, 하부 기판(110) 상에 박막트랜지스터(102, 104, 106, 108)와 유기발광 소자(112, 114, 116), 각종 기능 층이 위치하고 있다.
- [0028] 하부 기판(또는 TFT 어레이 기판)은 유리 또는 플라스틱 기판일 수 있다. 플라스틱 기판인 경우, 폴리이미드 계열 또는 폴리 카보네이트 계열 물질이 사용되어 가요성(flexibility)을 가질 수 있다.
- [0029] 박막트랜지스터는 하부 기판(110) 상에 반도체층(102), 게이트 절연막(103), 게이트 전극(104), 층간 절연막(105), 소스 및 드레인 전극(106, 108)이 순차적으로 배치된 형태일 수 있다.
- [0030] 반도체층(102)은 폴리 실리콘(p-Si)으로 만들어질 수 있으며, 이 경우 소정의 영역이 불순물로 도핑될 수도 있다. 또한, 반도체층(102)은 아몰포스 실리콘(a-Si)으로 만들어질 수도 있고, 펜타센 등과 같은 다양한 유기 반도체 물질로 만들어질 수도 있다. 나아가 반도체층(102)은 산화물(oxide)로 만들어질 수도 있다. 반도체층(102)이 폴리 실리콘으로 형성될 경우 아몰포스 실리콘을 형성하고 이를 결정화시켜 폴리 실리콘으로

변화시키는데, 이러한 결정화 방법으로는 LTA(Lapid Thermal Annealing) 공정, MILC(Methal Induced Lateral Crystallization) 또는 SLS 법(Sequential Lateral Solidification) 등 다양한 방법이 적용될 수 있다.

- [0031] 게이트 절연막(103)은 실리콘 산화막(SiO_x) 또는 실리콘 질화막(SiN_x) 등과 같은 절연성 물질로 형성될 수 있으며, 이외에도 절연성 유기물 등으로 형성될 수도 있다. 게이트 전극(104)은 다양한 도전성 물질, 예컨대, 마그네슘(Mg), 알루미늄(Al), 니켈(Ni), 크롬(Cr), 몰리브덴(Mo), 텅스텐(W), 금(Au) 또는 이들의 합금 등으로 형성될 수 있다.
- [0032] 층간 절연막(105)은 실리콘 산화막(SiO_x) 또는 실리콘 질화막(SiN_x) 등과 같은 절연성 물질로 형성될 수 있으며, 이외에도 절연성 유기물 등으로 형성될 수도 있다. 층간 절연막(105)과 게이트 절연막(103)의 선택적 제거로 소스 및 드레인 영역이 노출되는 컨택 홀(contact hole)이 형성될 수 있다.
- [0033] 소스 및 드레인 전극(106, 108)은 컨택 홀이 매립되도록 층간 절연막(105) 상에 게이트 전극(104)용 물질로 단일층 또는 다층의 형상으로 형성된다.
- [0034] 박막트랜지스터 상에 보호막(107)이 위치할 수 있다. 보호막(107)은 박막트랜지스터를 보호하고 평탄화시킨다. 보호막(107)은 다양한 형태로 구성될 수 있는데, BCB(Benzocyclobutene) 또는 아크릴(Acryl) 등과 같은 유기 절연막, 또는 실리콘 질화막(SiN_x), 실리콘 산화막(SiO_x)와 같은 무기 절연막으로 형성될 수도 있고, 단층으로 형성되거나 이중 혹은 다층 층으로 구성될 수도 있는 등 다양한 변형이 가능하다.
- [0035] 유기발광 소자는 제1 전극(112), 유기발광 층(114), 제2 전극(116)이 순차적으로 배치된 형태일 수 있다. 즉, 유기발광 소자는 보호막(107) 상에 형성된 제1 전극(112), 제1 전극(112) 상에 위치한 유기발광 층(114) 및 유기발광 층(114) 상에 위치한 제2 전극(116)으로 구성될 수 있다.
- [0036] 제1 전극(112)은 컨택 홀을 통해 구동 박막트랜지스터의 드레인 전극(108)과 전기적으로 연결된다. 유기발광 표시장치(100)가 상부 발광(top emission) 방식인 경우, 이러한 제1 전극(112)은 반사율이 높은 불투명한 도전 물질로 만들어질 수 있다. 예를 들면, 제1 전극(112)은 은(Ag), 알루미늄(Al), 금(Au), 몰리브덴(Mo), 텅스텐(W), 크롬(Cr) 또는 이들의 합금 등으로 형성될 수 있다.
- [0037] बैं크(109)는 발광 영역을 제외한 나머지 영역에 형성된다. 이에 따라, बैं크(109)는 발광영역과 대응되는 제1 전극(112)을 노출시키는 बैं크 홀을 가진다. बैं크(109)는 실리콘 질화막(SiN_x), 실리콘 산화막(SiO_x)와 같은 무기 절연 물질 또는 BCB, 아크릴계 수지 또는 이미드계 수지와 같은 유기 절연물질로 만들어질 수 있다.
- [0038] 유기발광 층(114)이 बैं크(109)에 의해 노출된 제1 전극(112) 상에 위치한다. 유기발광 층(114)은 발광층, 전자주입층, 전자수송층, 정공수송층, 정공주입층 등을 포함할 수 있다.
- [0039] 제2 전극(116)이 유기발광층(114) 상에 위치한다. 유기발광 표시장치(100)가 상부 발광(top emission) 방식인 경우, 제2 전극(116)은 인듐 틴 옥사이드(Indium Tin Oxide; ITO) 또는 인듐 징크 옥사이드(Indium Zinc Oxide; IZO) 등과 같은 투명한 도전 물질로 형성됨으로써 유기발광 층(114)에서 생성된 광을 제2 전극(116) 상부로 방출시킨다.
- [0040] 보호 층(passivation layer) (120)이 제2 전극(116) 상에 위치한다. 이때, 보호 층(120)은 유리, 금속, 산화알루미늄(AlO_x) 또는 실리콘(Si) 계열 물질로 이루어진 무기막으로 구성되거나, 또는 유기막과 무기막이 교대로 적층된 구조일 수도 있다. 보호 층(120)은, 발광 재료와 전극 재료의 산화를 방지하기 위하여, 외부로부터의 산소 및 수분 침투를 막는다. 유기발광 소자가 수분이나 산소에 노출되면, 발광 영역이 축소되는 화소 수축(pixel shrinkage) 현상이 나타나거나, 발광 영역 내 흑점(dark spot)이 생길 수 있다.
- [0041] 봉지 층(encapsulation layer, 140)이 보호 층(120) 상에 위치할 수 있다. 봉지 층(140)은 하부 기관(110)에 배치된 유기발광 소자를 밀봉한다. 여러 가지 봉지 구조가 적용될 수 있으나, 본 명세서에서는 면 봉지(face seal) 구조물이 사용되는 봉지 구조의 경우를 설명한다. 상기 면 봉지(face seal) 구조물의 일 예는 면 접착(face seal adhesive) 필름이다. 상기 면 접착 필름(140)은 밀봉 역할과 함께 하부 기관(110)과 상부 기관(190)을 접착하는 역할을 한다.
- [0042] 한편, 하부 기관(110) 아래에는 하부 접착 층(160)과 하부 봉지 층(170)이 순차적으로 형성되어 있다. 하부 봉지 층(170)은 폴리에틸렌 나프탈레이트 (Polyethylene Naphthalate; PEN), 폴리에틸렌테레프탈레이트 (Polyethylene Terephthalate; PET), 폴리에틸렌 에테르프탈레이트 (polyethylene ether phthalate), 폴리카보네이트 (polycarbonate), 폴리아릴레이트 (polyarylate), 폴리에테르이미드 (polyether imide), 폴리에테르술폰산 (polyether sulfonate), 폴리이미드 (polyimide) 또는 폴리아크릴레이트 (polyacrylate)에서 선택된 하나

이상의 유기 물질로 형성될 수 있다. 하부 봉지 층(170)은 외부로부터 수분 또는 산소가 기관으로 침투하는 것을 방지하는 역할을 한다.

- [0043] 하부 접착 층(160)은 열 경화형 또는 자연 경화형의 접착제로 형성되며, 하부 기관(110)과 하부 봉지 층(170)을 접착시키는 역할을 한다. 예를 들어, 하부 접착 층(160)은 OCA(Optical Cleared Adhesive) 등의 물질로 형성될 수 있다.
- [0044] 도 3은 유기발광 표시장치의 면 봉지재를 나타낸 도면이다.
- [0045] 유기발광 표시장치(100)는 TFT 어레이 기관(110), 픽셀구동회로 및 유기발광 소자(TFT/OLED), 면 봉지재(140) 및 봉지 기관(190)을 포함할 수 있다.
- [0046] 하부 기관(110)은 절연 물질로 형성되며, 유기발광 표시장치(100)의 다양한 구성요소들을 지지한다.
- [0047] 픽셀구동회로 및 유기발광 소자(TFT/OLED)는 하부 기관(110) 상에 배치된다. 유기발광 소자는 애노드(anode), 애노드 상에 형성된 유기발광 층, 유기발광 층 상에 형성된 캐소드(cathode)를 포함한다. 유기발광 층은 하나의 빛을 발광하는 단일 발광층 구조일 수도 있고, 복수 개의 발광층으로 구성되어 백색 광을 발광하는 구조일 수도 있다. 유기발광 소자는 표시 영역에 대응하도록 하부 기관(110)의 중앙 부분에 형성될 수 있다. 유기발광 소자를 구동하기 위한 픽셀구동회로, 즉 박막 트랜지스터(thin film transistor), 커패시터(capacitor) 등의 다양한 소자 및 배선들이 유기발광 소자와 연관되어 배치될 수 있다. 픽셀구동회로 및 유기발광 소자의 예시적인 구조와 기능은 도 2에서 설명된 것과 실질적으로 동일하다.
- [0048] 픽셀구동회로 및 유기발광 소자(TFT/OLED)를 보호하기 위한 보호막(passivation)이 유기발광 소자를 덮도록 위치할 수 있다. 보호막(120)은 무기막으로 구성되거나, 또는 유기막과 무기막이 교대로 적층된 구조일 수도 있다.
- [0049] 면 봉지재(140)는 유기발광 소자를 밀봉하고, TFT 어레이 기관(110)과 봉지 기관(190)을 접착하는 부재이다. 면 봉지재(140)는 경화성 수지 및 경화성 수지에 분산된 수분 흡착제로 구성될 수 있다. 상기 봉지재(140)는 제1 접착층(141) 및 제2 접착층(142)을 포함하는 면 접착 필름일 수 있다.
- [0050] 이때, 제1 접착층(141)은 배리어 층(barrier layer, B-layer)으로 호칭되기도 하며, 봉지 기관(190)의 일 면(하부 기관을 향하는 면)과 접합될 수 있다. 제1 접착층(141)은 수분 흡착제(141a) 및 경화성 수지(141b)를 포함한다. 제1 접착층(141)의 수분 흡착제(141a)는 물리적 또는 화학적 반응 등을 통해 외부로부터 유입되는 수분 또는 산소를 흡착 또는 제거한다.
- [0051] 제2 접착층(142)은 투명 층(transparent layer, T-layer)으로 호칭되기도 하며, 하부 기관(110) 및 유기발광 소자와 접합될 수 있다. 제2 접착층(142)은 열 경화성 수지 또는 광 경화성 수지일 수 있다.
- [0052] 봉지 기관(encapsulation plate)은 TFT 어레이 기관(110)과 대향한다. 구체적으로, 봉지 기관(190)은 하부 TFT 어레이 (110)과 대향하도록 배치되고, 봉지 기관(190)의 하면은 면 접착 필름(140)과 접한다. 봉지 기관(190)은 유리, 플라스틱, 금속 등과 같은 물질로 형성될 수 있고, 봉지 기관(190)의 구성 물질은 유기발광 표시장치(100)의 발광 방향에 따라 결정될 수도 있다.
- [0053] 도 4a 및 4b는 면 접착 필름에서 나타날 수 있는 문제를 나타낸 도면이다.
- [0054] 면 접착 필름은 유기발광 소자 상부에 접착되는 것이므로, 그 하부 면이 유기발광 소자 또는 보호막과 잘 합착되는 것이 중요하다. 그러나, 합착성 증가를 위해 특정 물성이 높아지면 다른 성질이 저하되는 경우가 있다. 예를 들어, 합착성을 향상하기 위해 면 접착 필름(특히, T-Layer)의 재질을 연성(soft)화할수록 필름이 필요 이상으로 늘어나는 현상이 나타난다. 반대로, 늘어남 방지 위해 면 접착 필름의 재질을 경성(rigid)화하면, 접착면 사이에 갇히는 기포가 다량 발생하여 표시장치의 신뢰성이 나빠진다.
- [0055] 도 4a를 보면, 면 접착 필름(140)은, 픽셀구동회로 및 유기발광 소자(TFT/OLED)와 상부 봉지 기관(190) 사이에 위치한다. 통상적으로 면 접착 필름(140)이 봉지 기관(190)에 먼저 부착된 후, 면 접착 필름(140)이 픽셀구동회로 및 유기발광 소자(TFT/OLED)를 마주보도록 하여 봉지 기관(190)과 하부 기관이 합착된다. 이 과정에서 가정화(반경화)상태의 면 접착 필름(특히 T-layer)은 상하로 눌려지는 압력을 받게 되어 좌우로 부피가 팽창한다. 이 때 면 접착 필름(특히 T-layer)의 재질이 연성일수록, 즉 점성이 작을수록 그 팽창하는 정도도 커져서, A와 같이 표시장치의 모서리 바깥까지 면 접착 필름이 늘어나는 경우도 있다. 이러한 현상으로 표시장치 및 합착 장비가 오염되어 제품 및 장비 불량률이 야기된다.

- [0056] 반면, 면 접착 필름의 늘어남을 줄이기 위해 상대적으로 딱딱한 재질을 사용하면, 도 4b와 같이 유기발광 소자의 상면 또는 측면 단차를 완전히 메우지 못한다. 이 경우 그 틈(B)에 공기(기포)가 갇히게 되어 투습 방지 성능이 현저히 저하되고, 결국 표시장치의 신뢰성이 낮아지게 된다.
- [0057] 본 발명의 발명자들은 이러한 현상을 인지하고, 면 접착 필름의 구조 및 재료를 개선하여 늘어남을 최소화하면서도 합착 기포를 효과적으로 제거할 수 있는 방안을 도출하였다.
- [0058] 도 5는 본 명세서의 일 실시예에 따른 면 봉지재를 나타낸 단면도이다.
- [0059] 상기 면 봉지재(face seal encapsulation)는, 유기발광 소자로의 수분/산소의 침투를 막는, 다수 레이어(layer)가 상하(수직)으로 적층된 다층(multi-layer) 구조의 면 접착(face seal adhesive) 필름일 수 있다. 상기 면 봉지재(140-1)는 경화성 수지(resin) 및 수분 흡착제의 혼합물로 구성될 수 있다. 예컨대, 상기 다수의 레이어 중 어느 하나 이상의 레이어는 수분 흡착제를 포함한 경화성 수지로 이루어지고, 다른 레이어는 경화성 수지만 이루어질 수 있다.
- [0060] 상기 면 봉지재의 일 실시예로 다층 구조의 면 접착(face seal adhesive) 필름(140-1)이 유기발광 표시장치에 적용될 수 있다. 상기 면 접착 필름(140-1)은 유기발광 소자를 밀봉하고, TFT 어레이 기판과 봉지 기판을 접착시킨다. 상기 면 접착 필름(140-1)은 경화성 수지 및 경화성 수지에 분산된 수분 흡착제를 포함할 수 있다. 상기 경화성 수지는 면 접착 필름(140-1)의 베이스 물질로서, 열 경화성 수지 또는 광 경화성 수지로 이루어질 수 있다. 상기 경화성 수지는 에폭시(epoxy)계, 올레핀(olefin)계 등의 폴리머(polymer) 물질로 이루어질 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0061] 상기 면 접착 필름(140-1)은 상하로 적층된 제1 봉지층(141-1) 및 제2 봉지층(142-1)을 포함할 수 있다. 이때 상기 제1 봉지층(141-1)은, TFT 어레이 기판과 대향하는 봉지 기판의 일 면(TFT 어레이 기판을 향하는 면)에 직접 접착되거나, 또는 다른 기능 층을 사이에 두고 상기 봉지 기판과 대향한다. 상기 봉지 기판은 금속 또는 유리로 이루어진 기판일 수 있다. 상기 제2 봉지층(141-2)은, 상기 제1 봉지층(141-1)과 접착된 제1 면, 및 상기 제1 면의 반대 면에서 유기발광 소자의 상부를 덮는 제2 면을 갖는다. 상기 제2 봉지층(142-1)의 상기 제2 면은, 유기발광 소자 (또는 그 위의 보호막) 및 유기발광 소자 주위의 TFT 어레이 기판과 접착된다.
- [0062] 제1 봉지층(또는 제1 접착층)은 배리어 층(barrier layer, B-layer)으로 호칭되기도 한다. 제1 봉지층(141-1)은 수분 흡착제(141-1a)를 포함하는 경화성 수지(141-1b)를 기초로 하여 만들어진다. 상기 수분 흡착제(141-1a)는 물리적 또는 화학적 반응 등을 통해, 외부로부터 유입되는 수분 또는 산소를 흡착 또는 제거한다. 예를 들어, 수분 흡착제(141-1a)는 면 접착 필름(140-1) 내부로 유입된 수분 또는 산소 등과 화학적으로 반응하여 수분 또는 산소를 흡착하는 반응성 흡착제이거나, 봉지 구조로 침투하는 수분 또는 산소의 이동 경로를 길게 하여 침투를 억제하는 물리적 흡착제일 수 있다. 수분 흡착제(141-1a)의 구체적인 종류는 제한되지 않는다. 예를 들어, 수분 흡착제(141-1a)로 알루미나(alumina) 등의 금속 분말, 금속 산화물, 금속염, 오산화인(P2O5) 등의 일종 또는 이종 이상의 혼합물과 같은 반응성 흡착제가 사용될 수 있다, 또 다른 예로서, 수분 흡착제(141-1a)로 실리카(silica), 제올라이트(zeolite), 티타니아(titania), 지르코니아(zirconia), 몬모릴로나이트(montmorillonite) 등과 같은 물리적 흡착제가 사용될 수 있다.
- [0063] 상기 금속 산화물은, 산화리튬(Li₂O), 산화나트륨(Na₂O), 산화바륨(BaO), 산화칼슘(CaO) 또는 산화마그네슘(MgO) 등일 수 있다. 또한, 상기 금속염은, 황산리튬(Li₂SO₄), 황산나트륨(Na₂SO₄), 황산칼슘(CaSO₄), 황산마그네슘(MgSO₄), 황산코발트(CoSO₄), 황산갈륨(Ga₂(SO₄)₃), 황산티탄(Ti(SO₄)₂) 또는 황산니켈(NiSO₄) 등과 같은 황산염일 수 있다. 뿐만 아니라, 상기 금속염은, 염화칼슘(CaCl₂), 염화마그네슘(MgCl₂), 염화스트론튬(SrCl₂), 염화이트륨(YCl₃), 염화구리(CuCl₂), 불화세슘(CsF), 불화탄탈륨(TaF₅), 불화니오븀(NbF₅), 브롬화리튬(LiBr), 브롬화칼슘(CaBr₂), 브롬화세슘(CeBr₃), 브롬화셀레늄(SeBr₄), 브롬화바나듐(VBr₃), 브롬화마그네슘(MgBr₂), 요오드화바륨(BaI₂) 또는 요오드화마그네슘(MgI₂) 등과 같은 금속할로젠화물 또는 과염소산바륨(Ba(ClO₄)₂), 과염소산마그네슘(Mg(ClO₄)₂) 등과 같은 금속염소산염 등일 수 있다. 다만, 수분 흡착제는 상술한 예시적인 물질로 제한되는 것은 아니다.
- [0064] 제2 봉지층(또는 제2 접착층)은 투명 층(transparent layer, T-layer)으로 호칭되기도 한다. 제2 봉지층(142-1)은 미세 구조체(142-1a)를 포함하는 경화성 수지를 기초로 하여 만들어진다. 제2 봉지층(142-1)의 경화성 수지는, 제1 봉지층(141-1)을 구성하는 경화성 수지(141-1b)와 동일한 물질을 포함하는 경화성 수지일 수도 있고, 다른 물질을 포함하는 경화성 수지일 수도 있다. 예를 들어, 글리시딜(glycidyl)기, 이소시아네이트(isocyanate)기, 히드록시(hydroxyl)기, 카르복실(Carboxyl)기 또는 아미드(amide)기 등과 같은 열 경화 가능

한 관능기를 하나 이상 포함하는 열 경화성 수지일수 있다. 또한 상기 제2 봉지층(142-1)은 투명한 경화성 수지로 이루어질 수 있다. 한편, 상기 제2 봉지층(142-1)은 상기 TFT 어레이 기판과의 합착 시에 가해지는 압력을 완충하는 역할을 할 수 있다.

[0065] 상기 미세 구조체(142-1a)는 상기 면 봉지재와 상기 유기발광 소자와의 합착 시에 상기 제2 봉지층(142-1)의 점성(viscosity)을 증가시키는 역할을 한다. 즉, 상기 제2 봉지층(142-1)은, 합착 시에 외부로부터 압력을 받으면 상기 미세 구조체(142-1a)로 인하여 딜레이턴트(dilatant) 성질을 갖게 되어 점성이 증가한다. 그러므로, 상기 제2 봉지층(142-1)은, 상기 미세 구조체(142-1a)로 인하여, 유기발광 소자의 상부에 부착될 때 합착 압력에 의해 발생하는 팽창이 억제된다.

[0066] 일반적인 고분자 폴리머(polymer)의 경우, 시간당 전단력(Shear rate)이 증가하면 폴리머 체인(polymer chain)들의 미끄러짐(slip) 현상으로 점도가 감소하는 경향을 보인다. (Shear Thinning, Thixotropy) 그러나, 폴리머 내에 미세한 크기(nano size)의 구조체(예: clay)들이 고르게 분산되어 있으면, 미세 구조체와 폴리머, 또는 미세 구조체 간의 상호작용으로 (시간당 전단력이 증가해도) 점도가 증가하는 현상이 나타난다. (Shear Thickening, Dilatant) 어레이 기판과 봉지 기판의 합착 과정은 면 접착 필름에 큰 전단력(shearing force)이 주어지는 상황이므로, 제2 봉지층(142-1)에 미세 구조체가 분산되어 있으면 이 상황에서 제2 봉지층의 점도가 증가하게 된다.

[0067] 따라서, 상기 제2 봉지층(142-1)은, TFT 어레이 기판과 유기발광 소자와의 접착 공정에서 면 봉지 필름에 전단력(shearing force)이 가해지는 경우에, 상기 미세 구조체(142-1a)로 인하여 그 점성이 증가한다. 그 결과, 상기 제2 봉지층(142-1)은, 상기 접착 공정에서 상기 TFT 어레이 기판의 외부, 즉 표시장치의 바깥으로 흘러 넘치지 않게 된다.

[0068] 상기 미세 구조체(142-1a)는 크기가 작을수록 좋으며, 본 발명의 실시예에서는 100 나노미터(nm) 이하의 크기를 갖는다. (nano composite) 상기 미세 구조체(142-1a)는 미세 크기의 무기물 또는 무기물 복합체일 수 있으며, 일 예로 몬모릴로나이트 점토(montmorillonite clay)일 수 있다.

[0069] 상기 미세 구조체(142-1a)는 제2 봉지층(142-1) 내에 고르게 분산되는 것이 바람직하다. 상기 미세 구조체(142-1a)의 분산도를 측정하는 방법 중 하나는 엑스레이(X-Ray)를 사용한 측정이다. 엑스레이로 관찰할 때 미세 구조체들이 묻쳐있는 소각영역(SAXS)이 있다면 특정 피크(peak)를 볼 수 있다. 그러나 미세 구조체들이 고르게 분산되면 이러한 특정 피크가 사라지며 평탄(flat)한 결과가 나타난다. 엑스레이 관찰을 통해 물질 내 반복되어 나타나는 특정 물체의 길이에 대한 정보를 얻을 수 있다. 예를 들어 파티클(particle)들이 층을 이루고 있으면 층과 층 사이의 거리가 피크로 나타난다. 미세 구조체(예: nano clay)는 판상 구조가 일반적인데, 미세 구조체들이 응집되어 있으면 판상 구조의 특유의 피크가 관찰되며 그 밀도도 크다. 반면, 미세 구조체의 분산이 고를수록 삽입(intercalation) 구조를 거쳐 완전 분산된 박리(exfoliation) 상태가 되고 피크의 강도 값이 감소하여 0에 가깝게 된다.

[0070] 도 6은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 면 봉지재를 나타낸 도면이다.

[0071] 상기 면 봉지재(face seal encapsulation)는, 유기발광 소자로의 투습을 막는 다층 구조의 면 접착 필름일 수 있다. 상기 면 봉지재(140-2)는 서로 접착된 제1 봉지층(141-2)과 제2 봉지층(142-2)을 포함할 수 있다. 상기 제1 봉지층(141-2)은, TFT 어레이 기판과 대향하는 봉지 기판의 일 면(TFT 어레이 기판을 향하는 면)에 직접 접착되거나, 또는 다른 기능 층을 사이에 두고 상기 봉지 기판과 대향한다. 상기 제2 봉지층(142-2)은 제1 봉지층(141-2)과 유기발광 소자의 사이에 위치한다.

[0072] 상기 제1 봉지층(141-2)에 대한 상세한 설명은 도 5에서 설명한 것과 실질적으로 동일하다. 상기 제2 봉지층(142-2)은 다수의 공극(pore)을 포함한다. 상기 공극(142-2b)은, 유기발광 소자 및/또는 TFT 어레이 기판과의 접착 시에, 상기 제2 봉지층(142-2)과 유기발광 소자의 상면 사이에 갇힌, 공기(기포)가 빠져나가도록 구비된 것이다. 도 4b에서 설명한 것과 같이, 면 접착 필름의 점성이 크면, 유기발광 소자의 상면 또는 측면의 단차를 완전히 메우지 못하여 공기(기포)가 갇히게 된다. 그러나, 도 6에 도시한 것과 같이 접착층(제2 봉지층)에 공극이 갖춰진 구조(비유하자면 스폰지(sponge) 구조)라면, 갇힌 공기가 공극을 통해 빠져 나갈 수 있으므로 합착 기포로 인한 제품 불량률을 사전에 예방할 수 있게 된다. 이러한 공극 함유 구조는, 상대적으로 딱딱한 재질의 접착층을 갖거나, 도 5처럼 순간적으로 점성이 커지는 접착층에 유용하게 적용될 수 있다. 상기 공극(142-2b)은 제2 봉지층(142-2)의 제조 시에 발포제를 첨가함으로써 만들어질 수 있다.

[0073] 한편, 상기 공극(142-2b)을 통해 외부의 수분이 침투할 수도 있으므로, 공극 구조는 최소화되는 것이 바람직하

다. 즉, 제2 봉지층(142-2)의 두께는 얇게 하면서 제1 봉지층(141-2)의 흡습 능력을 늘리는 것이 바람직하다. 그러므로, 상기 제2 봉지층(142-2)의 두께는, 상기 공극(142-2b)이 차지하는 부피, 상기 공극(142-2b)을 통한 외기의 유입 등을 고려하여 결정될 수 있다. 이에 따라, 상기 제1 봉지층(141-2)은, 상기 제2 봉지층(142-2)의 두께에 기반하여 결정된 양의 수분 흡착제를 포함할 수 있다. 다시 말해 상기 제1 봉지층(141-2)은, 상기 제2 봉지층에서 상기 공극(142-2b)이 차지하는 부피, 상기 공극(142-2b)을 통한 외기의 유입 등을 고려하여 결정된 양의 수분 흡착제를 포함할 수 있다. 일 예로 공극(142-2b)의 부피가 10% 증가되면 제2 봉지층(142-2)의 두께는 5% 감소되고, 수분 흡착제의 양은 15% 증가될 수 있다.

[0074] 도 7은 본 명세서의 일 실시예에 따른 유기발광 표시장치를 나타낸 도면이다.

[0075] 유기발광 표시장치(100)는 하부 기판(110), 픽셀구동회로 및 유기발광 소자(TFT/OLED), 보호막(120), 면 봉지재(140-3), 봉지 기판(190) 등을 포함할 수 있다.

[0076] 하부 기판(110), 픽셀구동회로 및 유기발광 소자(TFT/OLED), 보호막(120) 및 봉지 기판(190)에 대한 상세한 설명은 도 1 내지 도 6에서 설명한 것과 실질적으로 동일하다.

[0077] 면 봉지재(140-3)은, 유기발광 소자 층을 덮어 수분 또는 산소의 침투를 막도록 구비된다. 상기 면 봉지재(140-3)는, 다수 레이어(layer)가 상하(수직)으로 적층된 다층(multi-layer) 구조의 면 접착 필름일 수 있다. 상기 면 봉지재(140-3)는 경화성 수지(resin) 및 기능성 첨가제의 혼합물로 구성될 수 있다.

[0078] 상기 면 봉지재(140-3)는 수분 흡착제(141-3a)를 함유한 제1 봉지층(141-3) 및 미세 구조체(142-3a)를 함유한 제2 봉지층(142-3)을 포함할 수 있다. 이때 상기 제1 봉지층(141-3)은, TFT 어레이 기판과 대향하는 봉지 기판의 일 면(TFT 어레이 기판을 향하는 면)에 직접 접촉되거나, 또는 다른 기능 층을 사이에 두고 상기 봉지 기판(190)과 대향한다. 상기 봉지 기판(190)은 금속 또는 유리로 이루어진 기판일 수 있다. 상기 제2 봉지층(142-3)은, 유기발광 소자 (또는 유기발광 소자 상의 보호막) 및 유기발광 소자 주위의 TFT 어레이 기판과 접촉된다.

[0079] 제1 봉지층(141-3)에 대한 상세한 설명은 도 5 내지 도 6에서 설명한 것과 실질적으로 동일하다.

[0080] 제2 봉지층(142-3)은 미세 구조체(142-3a)와 함께 유기발광 소자와 의 접촉 시에 갇힌 기포가 빠져나가기도록 구비된 공극(142-3b)을 더 포함할 수 있다. 도 7에는 미세 구조체(142-3a) 및 공극(142-3b)을 모두 포함하는 제2 봉지층(142-3)을 도시하였다.

[0081] 상기 제2 봉지층(142-3)은, 외부로부터 압력을 받으면 상기 미세 구조체(142-3a)로 인하여 딜레이턴트(dilatant) 성질을 갖게 된다. 따라서, 상기 제2 봉지층(142-3)은, 상기 유기발광 소자와의 접촉 공정에서 상기 면 봉지재에 전단력(shearing force)이 가해지는 경우에, 상기 미세 구조체(142-3a)로 인하여 점성이 증가하여 상기 TFT 어레이 기판(110)의 외부로 흘러 넘치지 않는다. 상기 미세 구조체(142-3a)는 100 나노미터(nm) 이하의 크기를 갖는 몬모릴로나이트 점토(montmorillonite clay)일 수 있다.

[0082] 상기 제2 봉지층(142-3a)의 두께는, 상기 공극(142-3b)이 차지하는 부피 및 상기 공극을 통한 외기의 유입을 고려하여 결정될 수 있다. 이때 상기 제1 봉지층(141-3)은, 상기 제2 봉지층(142-3)의 두께에 기반하여 결정된 양의 수분 흡착제(141-3a)를 함유할 수 있다.

[0083] 이외에도 상기 미세 구조체(142-3a) 및 공극(142-3b), 그리고 상기 제2 봉지층(142-3)의 특성은 도 5 내지 도 6에서 설명한 것과 동일하다. 따라서, 도 7에 예시된 유기발광 표시장치는, 도 5 내지 도 6에서 설명한 면 봉지재의 장점을 모두 갖는다.

[0084] 이상에서의 설명 및 첨부된 도면은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 나타낸 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 구성의 결합, 분리, 치환 및 변경 등의 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

부호의 설명

[0085] 100: 유기발광 표시장치

110: TFT 어레이 기판

120: 보호막

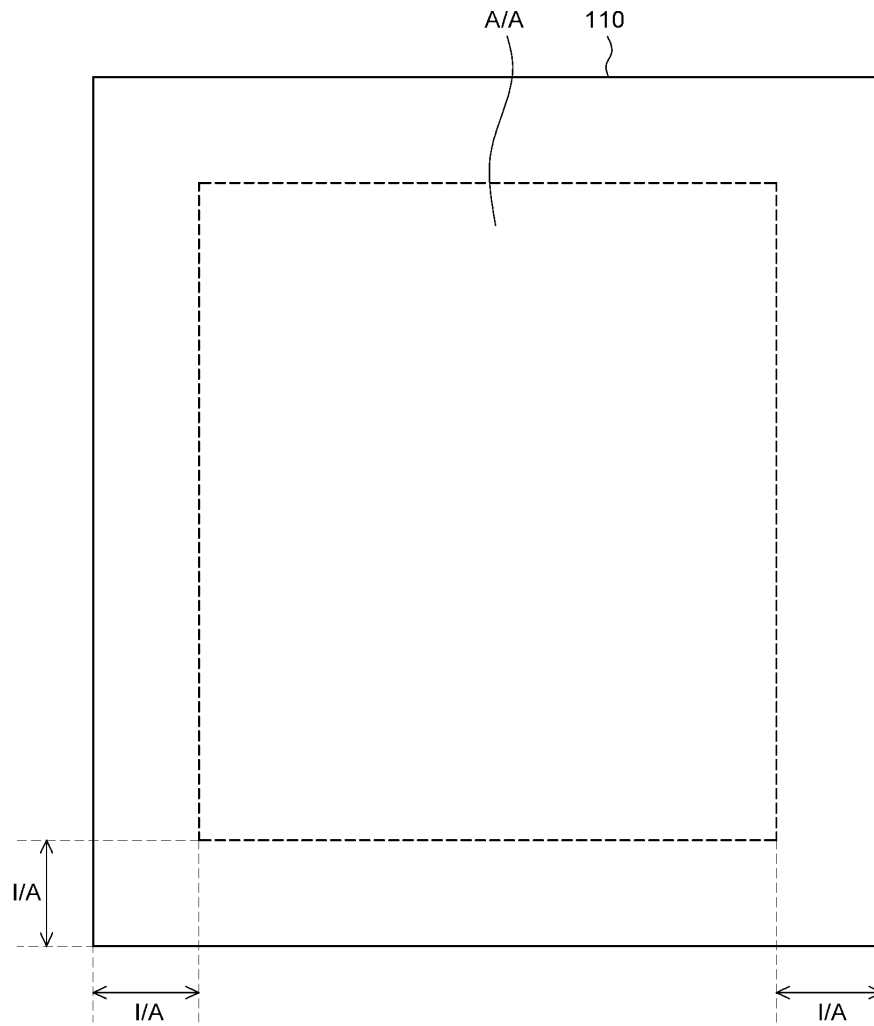
140, 140-1, 140-2, 140-3: 면 접착 필름

190: 봉지 기판

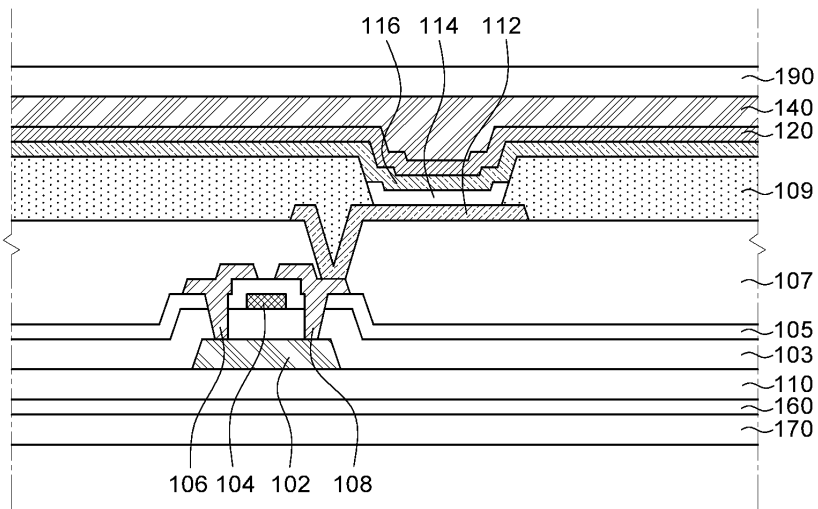
도면

도면1

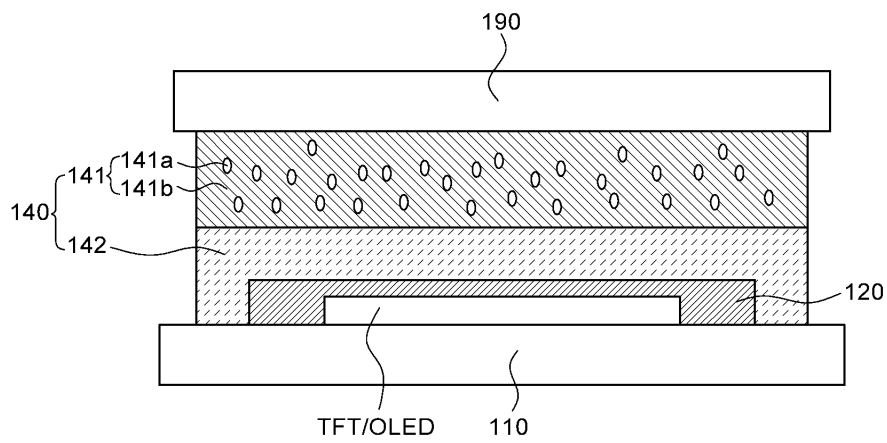
100



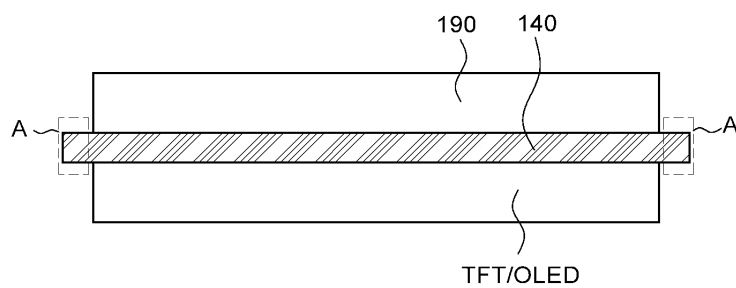
도면2



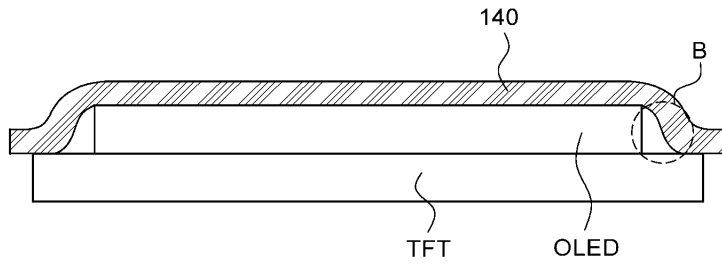
도면3



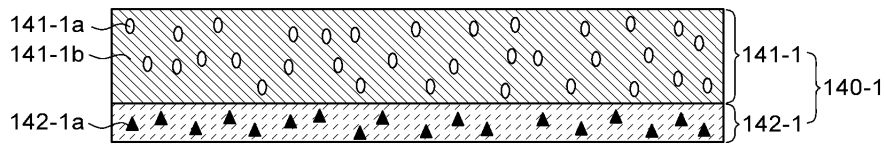
도면4a



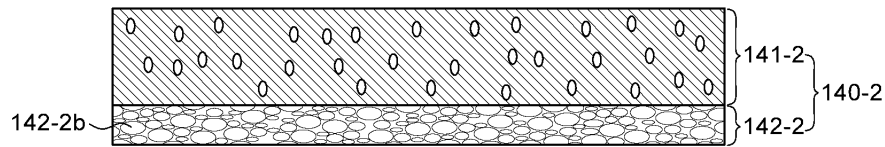
도면4b



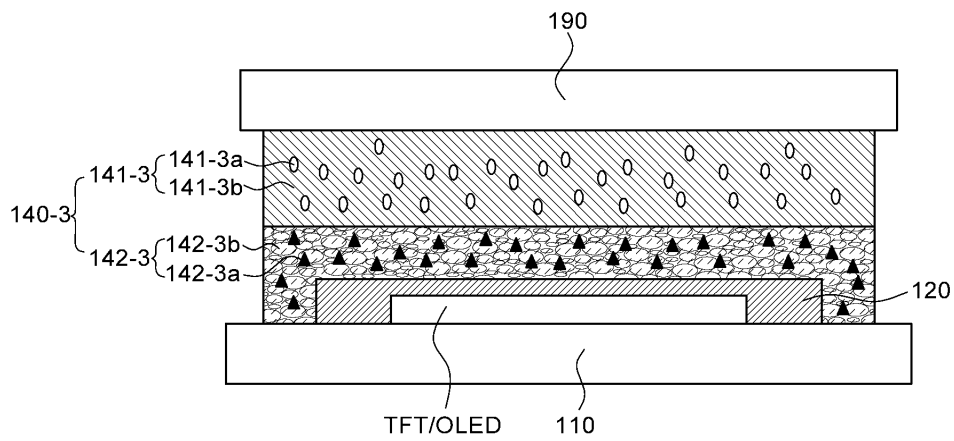
도면5



도면6



도면7



专利名称(译)	相关技术的描述		
公开(公告)号	KR1020170038544A	公开(公告)日	2017-04-07
申请号	KR1020150138055	申请日	2015-09-30
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	LEE SIN WOO 이신우		
发明人	이신우		
IPC分类号	H01L51/52 H01L27/32		
CPC分类号	H01L51/5246 H01L51/5253 H01L27/3262 H01L27/3225 H01L2227/32		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

顶部有机发光元件;并且,一种面层封装,其覆盖有机发光器件并防止水分或氧气渗透。面部密封剂包括含有水分吸附剂的第一封装层和含有微结构的第二封装层并且,当面封装材料和有机发光器件连接在一起时,微结构增加了第二封装层的粘度。

